

檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號

聯絡人：李蕙瑩 研究員

電話：02-2737-7150

傳真：02-2737-7607

電子信箱：vvlee@nstc.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年7月15日

發文字號：科會科字第1130048920號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：國科會與德國聯邦教育及研究部(BMBF)共同徵求2025-2028年「臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫」，自即日起至受理申請，請於2024年9月20日(週五)前完成線上申請並造冊函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依據本會及德國BMBF於2023年3月21日簽署臺德科學及技術合作協議(STA)，共同徵求旨揭計畫(第二期)，申請方式詳如附件公告申請須知及本會網頁「計畫徵求專區」。
- 二、本項徵件計畫期程以3年為原則，自2025年5月1日開始執行，臺德雙方計畫主持人共同研議計畫內容後，須分別向本會及德國BMBF於申請截止期限內提出申請書，始得成案。
- 三、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，本會與德方BMBF將於2024年8月7日(週三)下午，共同舉辦「臺德雙邊研究人員線上交流會議」，鏈結臺德半導體領域學者互動交流，歡迎有興趣學者線上參與，報名及參與方式另於本會網站公告。
- 四、本案聯絡人：
 - (一)相關計畫內容疑問，請洽本會科國處李蕙瑩研究員，電話：(02)2737-7150。
 - (二)有關係統操作問題，請洽本會資訊系統服務專線，電話：0800-212-058及(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位 (共298單位)

第1頁 共2頁

國立清華大學



1130014331

副本：本會工程處、科教國合處、駐德國代表處科技組(均含附件)

電子公文
交換章

——批核軌跡及意見——

